

TLC69697-Q1 車載対応 UART 互換接続機能 (TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリ向け)

1 特長

- 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
 - グレード 1: 周囲温度範囲: -40°C ~ 125°C
 - デバイス HBM 分類レベル H2
 - デバイス CDM 分類レベル C5
- 動作電圧 V_{CC} 範囲: 2.7V ~ 5.5V
- 制御インターフェイス オプション
 - UART シリアル通信
 - 最大 4MHz のデータ転送
 - 1つのバスで 4つのペリフェラルをサポート
 - CAN トランシーバ互換
- LED ドライバ SPI コントローラ
 - 最大 6.6MHz のデータ転送レート
 - EMI 耐性を強化できるプログラマブルなクロック ジッタ
- 保護機能と診断機能
 - オープンドレインの FAULT ピン
 - UART 通信喪失検出
 - 通信向けの CRC (巡回冗長検査)

- TLC69634Q1 と TLC69624Q1
- TLC69631Q1 と TLC69621Q1
- TLC69638Q1 と TLC69628Q1
- TLC69635Q1 と TLC69625Q1
- TLC69632Q1 と TLC69622Q1
- TLC69620Q1 と TLC69630Q1

3 説明

TLC69697-Q1 UART 互換接続機能を使うと、1つの UART コントローラを使用して、TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリを制御できます。本デバイスには、TLC696[2|3][0|1|2|4|5|7|8]-Q1 デバイス ファミリの SPI に必要なクロックを生成するための内部発振器が備わっています。送信データは、シリアル ペリフェラル インターフェイス (SPI) のタイミング要件を維持するため、連続クロックに合わせて調整されます。

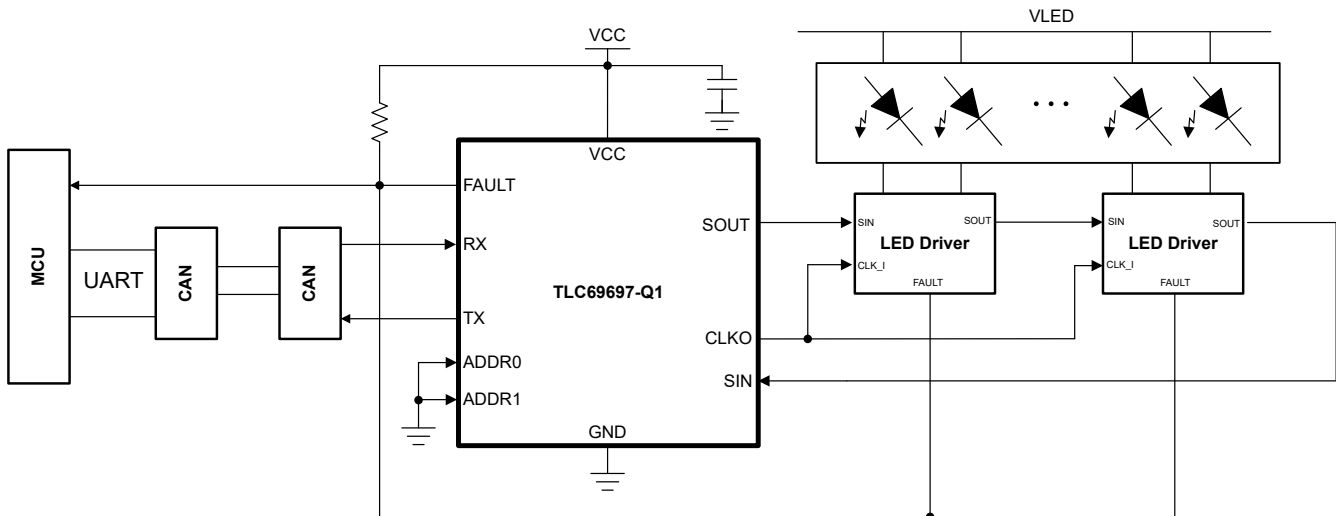
パッケージ情報

部品番号	パッケージ (1)	パッケージ サイズ(2)
TLC69697-Q1	SOT-23-THN (14)	4.20mm x 2.00mm

- (1) 利用可能なすべてのパッケージについては、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
- (2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値です。

2 アプリケーション

- 以下に対する UART 互換コネクティブティ
 - TLC69637Q1 と TLC69627Q1



代表的なアプリケーションの図



目次

1 特長.....	1	6.2 サポート・リソース.....	5
2 アプリケーション.....	1	6.3 商標.....	5
3 説明.....	1	6.4 静電気放電に関する注意事項.....	5
4 デバイス比較表.....	3	6.5 用語集.....	5
5 ピン構成および機能.....	4	7 改訂履歴.....	5
6 デバイスおよびドキュメントのサポート.....	5	8 メカニカル、パッケージ、および注文情報.....	5
6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法.....	5		

4 デバイス比較表

部品番号	材料	パッケージ
TLC69697-Q1	TLC69697QDYRQ1	SOT-23-THN (14)

5 ピン構成および機能

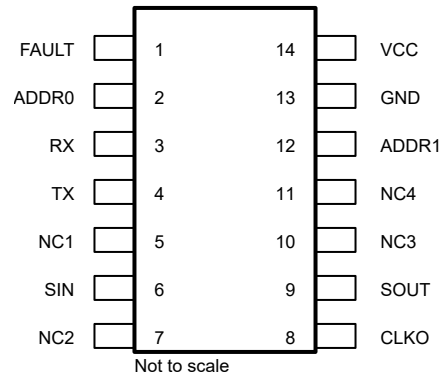


図 5-1. TLC69697-Q1 DYY パッケージ、14 ピン SOT-23-THN (上面図)

表 5-1. ピンの機能

ピン		タイプ ⁽¹⁾	説明
名称	DYY 番号		
ADDR0	2	I	UART インターフェイスのアドレス 0。
ADDR1	12	I	UART インターフェイスのアドレス 1。
CLKO	8	O	SPI クロック出力。
フォルト	1	O	フォルト インジケータ オープンドレイン出力。
GND	13	G	グラウンドピン。
NC1	5	NC	接続なし。
NC2	7	NC	接続なし。
NC3	10	NC	接続なし。
NC4	11	NC	接続なし。
RX	3	I	UART RX。
SIN	6	I	SPI データ入力。
SOUT	9	O	SPI データ出力。
TX	4	O	UART TX。
VCC	14	P	VCC 電源入力。

(1) I = 入力、O = 出力、I/O = 入力または出力、G = グラウンド、P = 電源。

6 デバイスおよびドキュメントのサポート

テキサス・インスツルメンツでは、幅広い開発ツールを提供しています。デバイスの性能の評価、コードの生成、ソリューションの開発を行うためのツールとソフトウェアを以下で紹介합니다。

6.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法

ドキュメントの更新についての通知を受け取るには、www.tij.co.jp のデバイス製品フォルダを開いてください。[通知] をクリックして登録すると、変更されたすべての製品情報に関するダイジェストを毎週受け取ることができます。変更の詳細については、改訂されたドキュメントに含まれている改訂履歴をご覧ください。

6.2 サポート・リソース

テキサス・インスツルメンツ E2E™ サポート・フォーラムは、エンジニアが検証済みの回答と設計に関するヒントをエキスパートから迅速かつ直接得ることができる場所です。既存の回答を検索したり、独自の質問をしたりすることで、設計に必要な支援を迅速に得ることができます。

リンクされているコンテンツは、各寄稿者により「現状のまま」提供されるものです。これらはテキサス・インスツルメンツの仕様を構成するものではなく、必ずしもテキサス・インスツルメンツの見解を反映したものではありません。テキサス・インスツルメンツの[使用条件](#)を参照してください。

6.3 商標

テキサス・インスツルメンツ E2E™ is a trademark of Texas Instruments.
すべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

6.4 静電気放電に関する注意事項



この IC は、ESD によって破損する可能性があります。テキサス・インスツルメンツは、IC を取り扱う際には常に適切な注意を払うことを推奨します。正しい取り扱いおよび設置手順に従わない場合、デバイスを破損するおそれがあります。

ESD による破損は、わずかな性能低下からデバイスの完全な故障まで多岐にわたります。精密な IC の場合、パラメータがわずかに変化するだけで公表されている仕様から外れる可能性があるため、破損が発生しやすくなっています。

6.5 用語集

[テキサス・インスツルメンツ用語集](#) この用語集には、用語や略語の一覧および定義が記載されています。

7 改訂履歴

資料番号末尾の英字は改訂を表しています。その改訂履歴は英語版に準じています。

日付	改訂	注
February 2026	*	初版リリース

8 メカニカル、パッケージ、および注文情報

以降のページには、メカニカル、パッケージ、および注文に関する情報が記載されています。この情報は、指定のデバイスに使用できる最新のデータです。このデータは、予告なく、このドキュメントを改訂せずに変更される場合があります。本データシートのブラウザ版を使用されている場合は、画面左側の説明をご覧ください。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
TLC69697QDYRQ1	Active	Production	SOT-23-THIN (DYY) 14	3000 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-1-260C-UNLIM	-40 to 125	TLC69697Q

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

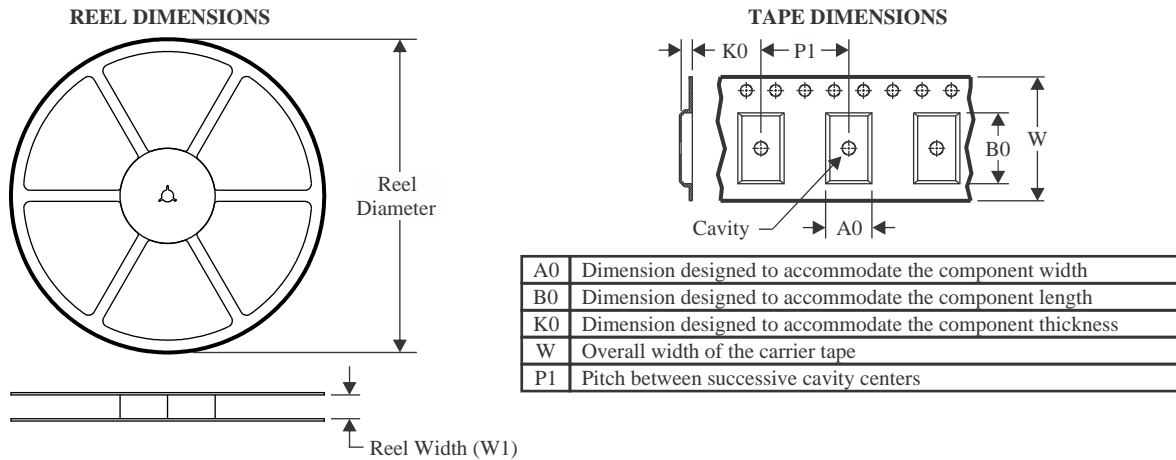
⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE

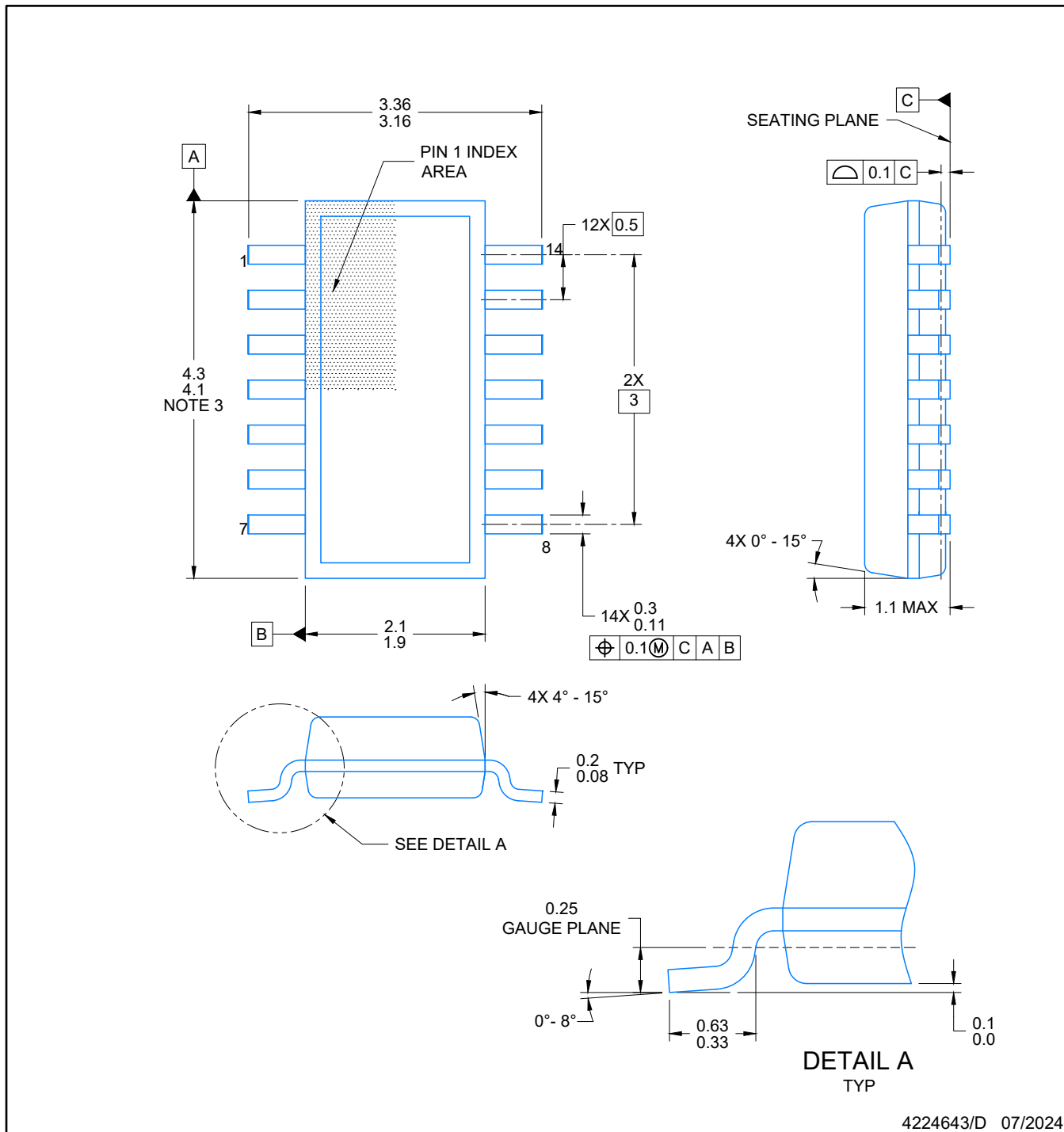

*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
TLC69697QDYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	330.0	12.4	4.8	3.6	1.6	8.0	12.0	Q3

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS


*All dimensions are nominal

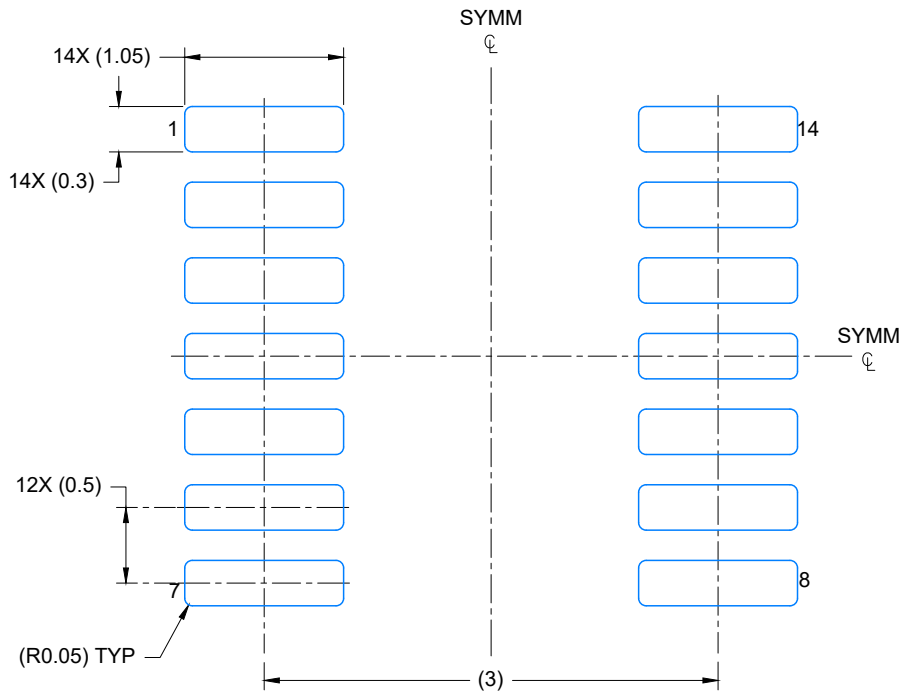
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
TLC69697QDYRQ1	SOT-23-THIN	DYY	14	3000	336.6	336.6	31.8



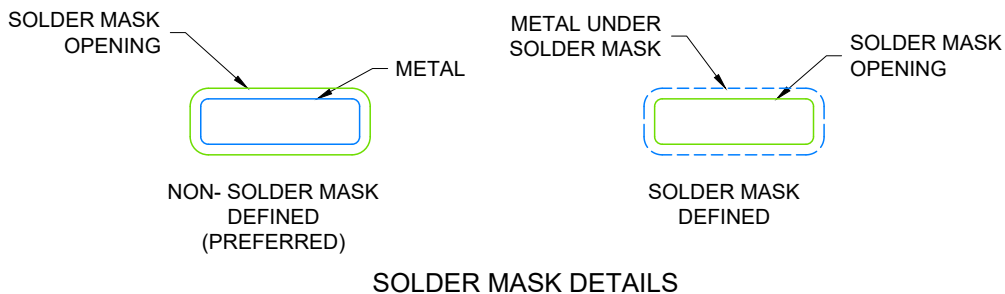
4224643/D 07/2024

NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.50 per side.
5. Reference JEDEC Registration MO-345, Variation AB



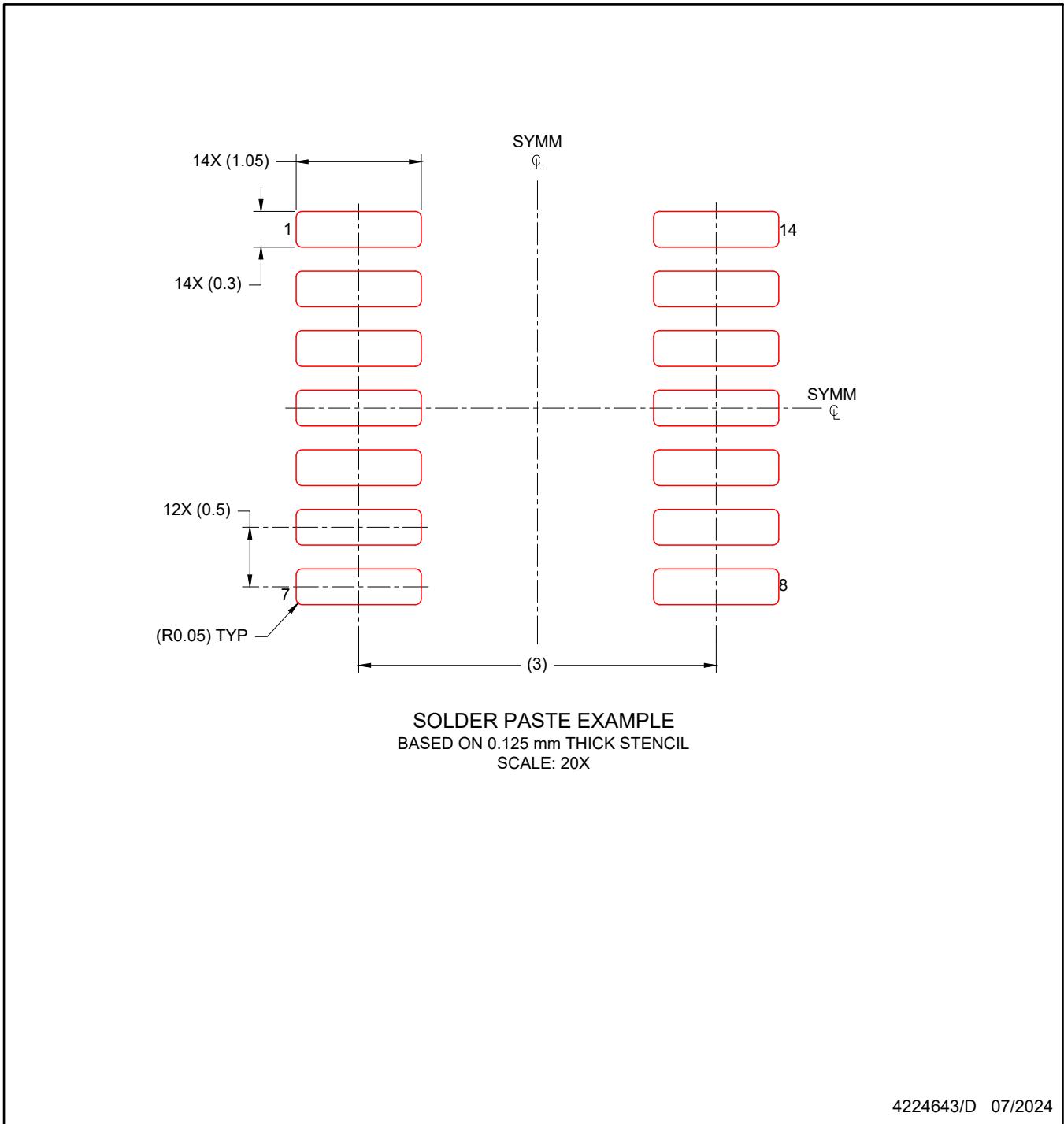
LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 20X



4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

- 6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.
- 7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.



4224643/D 07/2024

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

TI は、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、TI 製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した TI 製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとし、

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている TI 製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、TI はその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。TI や第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、TI およびその代理人を完全に補償するものとし、TI は一切の責任を拒否します。

TI の製品は、[TI の販売条件](#)、[TI の総合的な品質ガイドライン](#)、[ti.com](#) または TI 製品などに関連して提供される他の適用条件に従い提供されます。TI がこれらのリソースを提供することは、適用される TI の保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。TI がカスタム、またはカスタマー仕様として明示的に指定していない限り、TI の製品は標準的なカタログに掲載される汎用機器です。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案する場合も、TI はそれらに異議を唱え、拒否します。

Copyright © 2026, Texas Instruments Incorporated

最終更新日 : 2025 年 10 月